

令和7年9月12日

センシング技術・次世代パッケージングコンソーシアム
人・機械インタラクションWG

主査 武居 淳

副査 野村 健一、古志 知也

令和7年度 第3回 人・機械インタラクションWG
(福祉工学小WG) 開催のご案内

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、当コンソーシアムのワーキンググループ活動に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。下記要領にて、第3回WGを開催いたしますのでご出席のほどよろしくお願いいたします。

敬具

記

日時：2025年10月10日（金） 14:00～16:00

※お知らせ：同日に半導体製造センシング・実装技術WG@九州が開催されますが、どうしても開催日の調整が出来ない状況でした。大変申し訳ありませんが、ご了承いただけますようお願い申し上げます。

場所：東京ビッグサイト西・南展示場

※**集合場所は別途ご連絡**いたします。

※入場証の入手方法については、本WGに申し込みされた方に別途ご連絡差し上げます。

本WGにご参加の方におかれましては、WGへの申し込みに加え、**入場証をプリントアウトの上、当日ご持参ください。**

予定議題

14:00～15:50 国際福祉機器展見学（日大 依田先生にエスコートいただきます）

15:50～16:00 次回案内、事務連絡等、その後現地解散

【事務局】

国立研究開発法人産業技術総合研究所 センシング技術研究部門内

センシング技術・次世代パッケージングコンソーシアム

人・機械インタラクションWG事務局

M-stri-SenTePack-hint-ml@aist.go.jp

※現在参加者募集中